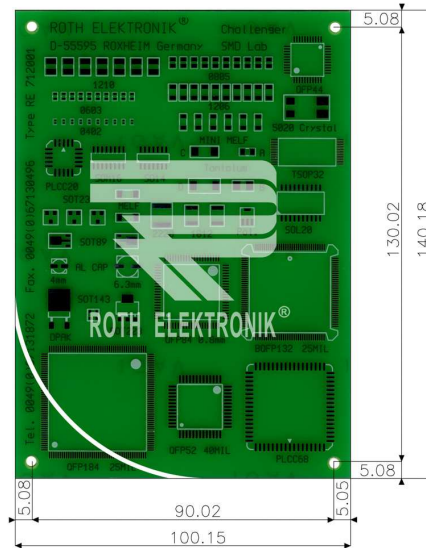


RE712001-LF

- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Single-sided 35 µm CU
- Without holes
- Hot air leveling (HAL-leadfree) with solder stop mask
- Component print
- PCB for 85 solder practices for SMD standard, fine pitch, and discrete components: PLCC 52, 68, 20QFP 44, 84, 132, 184 sq, SOT23 3 x SOT89 2 x SOT143 1 x SOT233 1 x SO14 1 x SOM16 1 x SOL20 1 x Poti. 1 x DPAK 1 x Al. Kond. 6,30 mm 1 x Al. Kond. 4,00 mm 1 x Melf 2308 2 x Mini Melf 1206 6 x Tantal Chip Kond. A 1 Tantal Chip Kond. B 1 Tantal Chip Kond. C 1 Tantal Chip Kond. D 10402 Chip Kond. 10 x 0603 Chip Kond. 10 x 1206 Chip Kond. 10 x 0805 Chip Kond. 10 x 1210 Chip Kond. 7 x 2220 Chip Kond. 1 x 1812 Chip Kond 2 x TSOP32 1 x 5020 Schwingquarz 1 x
- Also very suitable for machine assembly (Pick and Place)
- Size 100 x 140 mm

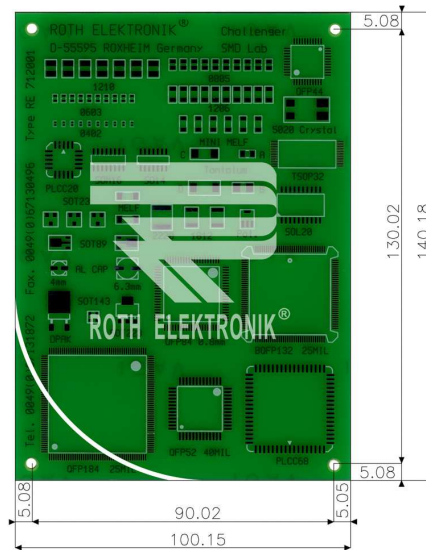
ver.20150130



RE712001-LF

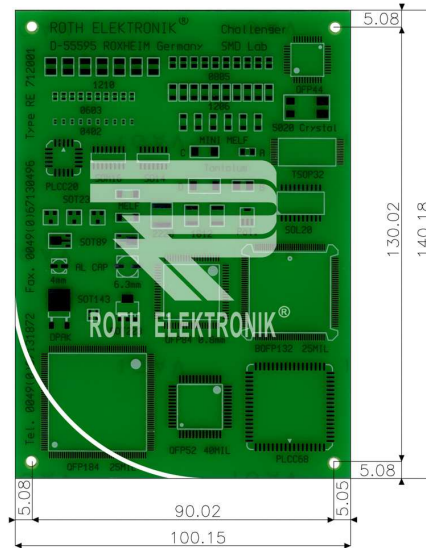
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Ohne Bohrungen
- Heißverzinnt (HAL-leadfree) mit Lötstopplack beschichtet
- Bestückungsdruck
- Platine für 85 SMD Standard-, Fine-Pitch und diskrete Bauelemente: PLCC 52, 68, 20QFP 44, 84, 132, 184 sq.SOT23 3 xSOT89 2 xSOT143 1 xSOT233 1 xSO14 1 xSOM16 1 xSOL20 1 xPoti. 1 xDPAK 1 xAl. Kond. 6,30 mm 1 xAl. Kond. 4,00 mm 1 xMelf 2308 2 xMini Melf 1206 6 xTantal Chip Kond. A 1Tantal Chip Kond. B 1Tantal Chip Kond. C 1 Tantal Chip Kond. D 10402 Chip Kond. 10 x0603 Chip Kond. 10 x1206 Chip Kond. 10 x0805 Chip Kond. 10 x1210 Chip Kond. 7 x2220 Chip Kond. 1 x1812 Chip Kond 2 xTSSOP32 1 x5020 Schwingquarz 1 x
- Auch sehr gut geeignet zur Maschinenbestückung (Pick & Place)
- Größe 100 x 140 mm

ver.20150130



RE712001-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Sans trous
- Étamée à chaud (HAL-leadfree) et un laque d'arrêt de soudure
- Impression d'insertion
- Platine pour 85 CMS standard, Fine-Pitch et composants discrets: PLCC 52, 68, 20QFP 44, 84, 132, 184 sq. SOT23 3 x SOT89 2 x SOT143 1 x SOT233 1 x SO14 1 x SOM16 1 x SOL20 1 x Poti. 1 x DPAK 1 x Al. Kond. 6,30 mm 1 x Al. Kond. 4,00 mm 1 x Melf 2308 2 x Mini Melf 1206 6 x Tantal Chip Kond. A 1 Tantal Chip Kond. B 1 Tantal Chip Kond. C 1 Tantal Chip Kond. D 10402 Chip Kond. 10 x 0603 Chip Kond. 10 x 1206 Chip Kond. 10 x 0805 Chip Kond. 10 x 1210 Chip Kond. 7 x 2220 Chip Kond. 1 x 1812 Chip Kond 2 x SOP32 1 x 5020 Schwingquarz 1 x
- Egalement très bien adaptée à l'insertion automatique (Pick & Place)
- Dimensions 100 x 140 mm



RE712001-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Sin perforación
- Estañado en caliente (HAL-leadfree) y revestido de laca inhibidora de soldadura
- Impresión de posición por el lado de los componentes
- placa de circuito impreso con 85 componentes SMD para ejercicios de soldadura SMD estándar, "Fine Pitch" y componentes discretos: PLCC 52, 68, 20QFP 44, 84, 132, 184 sq.SOT23 3 xSOT89 2 xSOT143 1 xSOT233 1 xSO14 1 xSOM16 1 xSOL20 1 xPoti. 1 xDPAK 1 xAl. Kond. 6,30 mm 1 xAl. Kond. 4,00 mm 1 xMelf 2308 2 xMini Melf 1206 6 xTantal Chip Kond. A 1Tantal Chip Kond. B 1Tantal Chip Kond. C 1Tantal Chip Kond. D 10402 Chip Kond. 10 x0603 Chip Kond. 10 x1206 Chip Kond. 10 x0805 Chip Kond. 10 x1210 Chip Kond. 7 x2220 Chip Kond. 1 x1812 Chip Kond 2 xTSOP32 1 x5020 Schwingquarz 1 x
- Muy adecuada también para la dotación automática Pick & Place)
- Tamaño: 100 x 140 mm

ver.20150130